高密度 D-Sub 连接器 ›



高密度 D-Sub 连接器以紧凑的外形实现每插针 5.0A 的额定高电流，与标准 D-sub 连接器相比，可在相同空间内支持更多的电路数量。精密加工触点、坚固的结构设计、多种触点配置，并提供 IP67 等级密封，可提升可靠性和多功能性，适用于广泛的应用场景。

优势和特性



极数	15、26、44、62、78
可用特性	防水 (IP67)，非磁性
电流	高达 5.0A
接触设计	直型 PCB、直角 PCB、压接、焊炉
耐用性	200 次或 500 次插拔
工作温度	-55°C 至 +115°C

最大限度减小高密度引脚连接的封装尺寸

高密度、精密加工触点提供多种镀层选项，在紧凑外形下最多可实现 78 极数配置，从而节省电路板或面板的空间。

降低现场故障和维护成本

坚固的结构设计和高插拔次数等级可确保长期可靠运行，并最大限度地减少返工。

可在恶劣的运行环境中使用

提供 IP67 等级密封，支持前面板或后面板两种安装方式，在连接器已插配或未插配状态下均可防止湿气或灰尘侵入，有助于避免现场故障。

简化系统设计

提供面板安装、浮动安装、盲插、卡扣式、螺栓固定、压接端子、密封式和非磁性版本等多种配置，以满足各种设计需求并加速工程开发进度。

避免干扰成像和测试设备

非磁性版本的相对磁导率为 1.0025，并经过 100% 测试，适用于医疗成像设备、测试/验证设备和高性能系统。

加快审批流程

依据欧洲指令 2011/65/EU RoHS 合规性，简化了验证/审评流程，并缩短了上市时间。

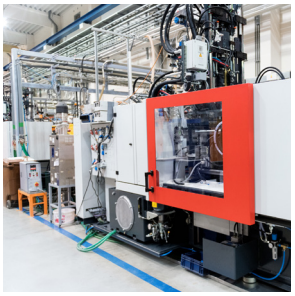
高密度 D-Sub 连接器 ›

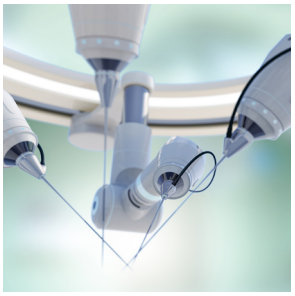
市场和应用

工业自动化
工业自动化设备
可再生能源系统
测试和测量设备

医疗
医疗设备
患者监护设备

运输
铁路运输设备


工业自动化设备


医疗设备


铁路运输设备

规格

参考信息
包装：纸板箱
设计单位：毫米
RoHS：是，依据 2011/65/EU 指令
可对配产品：IEC 60807-3、DIN 4165、MIL-DTL-24308
密封：可提供 IP67

电气
测试电压（最大值）：1,000V，持续 1 分钟
电流（最大值）：5.0A
接触电阻（最大值）：
直插触点—15 毫欧
直角触点—15 毫欧
触点之间的绝缘电阻（最小值）：
3,000 兆欧
相对磁导率（非磁性版本）：
μr ≤1.0025

机械
极数：15、26、44、62、78
每个信号触点的对配力（最大值）：3.4N
每个信号触点的拔脱力（最小值）：0.2N
扭矩（最大值）：40 Ncm（不适用于锁紧螺丝）
耐久度（最小值）：500 (G1) 或 200 (G2) 次插拔

物理
触点：铜合金
触点镀层：金覆镍
防水元件：硅胶
工作温度：-55°C 至 +115°C

www.molex.com/zh-cn

Molex 是 Molex, LLC 在美国的注册商标，并且可能已在其他国家/地区注册；此处列出的所有其他商标均是各自所有者的财产
订单编号 987651-6887 Rev. 1
USA/0k/GF/2026.09
©2026 Molex